

PCB加工工艺要求说明

1. 一般信息

1.0 主要技术联系人:	买买提	电话:	18875288184
	邮箱:	传真:	
1.1 其他技术联系人:	戴康明	电话:	13714646123
	丁朝阳	电话:	13927497578
		邮箱:	kangming.dai@hanputek.com
		邮箱:	zhaoyang.ding@hanputek.com
其他技术支持联系人: kangming.dai@hampoo.com			
注意: EQ确认单问请抄送上述所有邮箱, 如一定时间内未回复, 请电话联系“主要技术联系人”, 以保证第一时间确认工程问题, 谢谢!			

2. 工艺信息

2.0 板名:	CRD22DD12N_22KW_BI-OBC_MAIN_BOARD	特殊板种类:	一般通孔板
2.1 层数:	4层	最小孔径(mm):	0.3048
2.2 基材:	FR4	孔密度(个/平方米):	8670.64
2.3 厚径比:	7:1	最小线宽/距(mil):	6.00/5.00
翘曲度:	≤0.75%		
2.4 单板(Unit)尺寸(mm):	236.43 X 180.00	拼板方式:	1 X 1
拼板(Set)尺寸(mm):		每拼板(Set)单板(Unit)数:	1
组成拼板的单板种数:	1		
<input type="checkbox"/> V-CUT:			
2.5 板厚(mm):	2	公差: ±	10%
2.6 阻焊:	双面印	颜色:	绿色
2.7 字符:	双面印	颜色:	白色
标记:	<input checked="" type="checkbox"/> UL	标记所在层:	Silk Top
请不要在板内空白区域添加制板厂logo.			
请在板内空白区域添加板子生产日期.			
2.8 表面处理:	沉金	金厚: >=0.05um	镀金手指: <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 金厚:
金手指斜边:	<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No	
板厚削薄边:	<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No	
2.9 过孔阻焊处理方式:	<input checked="" type="checkbox"/> 除焊盘区域外整板塞孔	<input type="checkbox"/> BGA区域塞孔, 其他按Gerber	
	<input type="checkbox"/> 整板过孔塞孔	<input type="checkbox"/> 全部按Gerber	塞孔物质: 油墨
2.10 阻抗控制:	<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No	
2.11 盲孔/HDI:	<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No	
2.12 验收标准或规范:	<input checked="" type="checkbox"/> IPC-6012-II, current revision.		
2.13 IPC网表对比:	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	
2.14 交货附件:	<input checked="" type="checkbox"/> 电测报告	<input checked="" type="checkbox"/> 出货检测报告	<input checked="" type="checkbox"/> Gerber
	<input checked="" type="checkbox"/> PCB切片报告(最小直径过孔及内/外层线路位置)	<input type="checkbox"/> 阻抗测试报告	
	<input type="checkbox"/> 其他		
2.15 包装要求:	<input checked="" type="checkbox"/> 真空包装,	<input checked="" type="checkbox"/> 板间隔纸	

3. 叠层设置

REFERENCE LAYER STACKUP (Unit:mils)

2.00mm	37.00 mil	Core	16.00 mil Prepreg →	←Layer1	TOP	2.40 mil	Copper+Plating
			→	←Layer2	GND02	2.40 mil	
			→	←Layer3	POWER03	2.40 mil	
			16.00 mil Prepreg →	←Layer4	BOTTOM	2.40 mil	Copper+Plating